# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BÖRDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PAT-NO:

JP361251021A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61251021 A

TITLE:

FILMING APPARATUS

PUBN-DATE:

November 8, 1986

INVENTOR - INFORMATION: NAME TAKASAKI, KANETAKE KOYAMA, KENJI TSUKUNE, ATSUHIRO NISHIMURA, MASAHIDE SUGITA, MASAO

ASSIGNEE-INFORMATION: NAME

FUJITSU LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP60091938

APPL-DATE:

April 26, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/205, H01L021/31

US-CL-CURRENT: 257/E21.101

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To provide an electrode and a susceptor with physical and chemical stability as well as long life by a method wherein the surface of electrode and susceptor in a CVD apparatus is coated with titanium carbide of high thermal resistance stable to chemical reaction.

CONSTITUTION: A susceptor 15 whereon a substrate 14 is mounted is arranged

in a vacuum vessel 11 while the susceptor 15 is heated by a heater 16.

Besides, an electrode 17 is arranged above the substrate 14 opposing thereto

while both of the susceptor 15 and the electrode 17 are impressed with

high-frequency voltage by a high-frequency power supply 18. In such a

constitution, in order to provide the material of susceptor 15 and electrode 17

with high thermal resistance and corrosion resistance, the surface of aluminium

stainless steel shall be directly exposed. Therefore titanium carbide is used

as the optinum material for them to meet said requirements so that titanium

carbide layers 15' and 17' may be formed respectively on the surfaces of

susceptor 15 and electrode 17. At this time, plasma flame spray can be firstly

used as the coating process of titanium carbide layer.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

#### 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ⑩ 公開特許公報(A) 昭61-251021

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)11月8日

H 01 L 21/205 21/31 7739-5F 6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

#### 

②特 願 昭60-91938

②出 願 昭60(1985)4月26日

60条 明. 者 高 蓹 金 剛 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 勿発 明 者 Ш 堅 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 小 ⑫発 明 者 弘. 筑 根 敦 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 70発 明 者 村 正 秀 西 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 明 の発 者 杉 田 Œ 夫 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 砂出 顖 人 富士通株式会社 川崎市中原区上小田中1015番地

20代 理 人 弁理士 松岡 宏四郎

#### 明 精 書

#### 1. 発明の名称

#### 成膜装置

#### 2. 特許請求の範囲

試料を載置するためのサセプタ(15)の表面材質 が、

チタンカーパイドで形成されていることを特徴 とする成膜装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### [概要]

各種CVD等の成膜装置に使用される電極及び サセプタの耐蝕性と耐熱性を高めるために、従来 使用されている、アルミニウム又はステンレス材 質に代わり、アルミニウム又はステンレス表面に チタンカーバイドを被着して使用することにより、 高耐蝕性と耐熱性の双方を備えた電極及びサセプ タを提供する。

#### [産業上の利用分野]

本発明は、CVD等の成膜装置の電極構造に係

り、特に電極及びサセプタの材質に関するもので ある。

近時、半導体装置の製造工程では、CVD法による成膜、又はエッチングの手法として、各種CVD法、プラズマCVD法、スパック法、プラズマエッチング法等が広く利用されているが、これらの装置に使用される電極や、基板を載置するサセプタの材質は、従来からアルミニウムやステンレスが使用されている。

然しながら、これら電極やサセプタは、CVD 装置内における高温度の雰囲気に耐える耐熱性と 反応ガスとの化学反応による耐腐食性が必要であ り、従来のアルミニウムやステンレスでは、この 双方の要求には不敵であり、これの改善が要望さ れている。

#### [従来の技術]

第2図は、従来のプラズマCVD装置の要部模式断面図を示している。

C V D が行われる真空容器 1 があり、その真空容器には、成膜の種類に応じた反応ガスを供給す

る反応ガス供給孔 2 と反応ガス排出孔 3 が設けられている。

真空容器の内部には、半導体ウエのハの基板 4 を載置するサセプタ 5 があり、このサセプタ 5 は 加熱装置 6 によって加熱される。

叉、プラズマCVD装置では、基板4に対向して電極7が配置され、サセプタ5と電極7間に、高周波電線8によって高周波電圧が印加されている。

これら従来のCVD装置では、サセプタ5と電極7の材料は、アルミニウムか、ステンレスが使用されているのが一般的である。

通常、プラズマCVDは比較的低温の300℃程度でCVDが行われるために、低温で安定なアルミニウム電極が用いられ、例えばアモルファスシリコン膜の成膜等が行われる。

一方、燒珪酸ガラス (PSG)、窒化シリコン膜、二酸化シリコン膜、ポリシリコン膜等をCV D法により形成する場合には、650℃~850 での高温に加熱されるために、アルミニウム電極 を使用することが出来ないので、代わりにステンレスが用いられている。

この際に、アルミニウム電極は反応ガスと反応 して、その表面にアルミナ膜を形成するので化学 的な耐蝕性は強くなるが、アルミニウム自体の耐 熱性が劣り400℃以上になると、変形とか溶解 の恐れがある。

一方ステンレスは、耐熱性が優れ1000で以上の温度に耐えることができるが、高温の雰囲気中で反応がスにより、化学反応をして酸化やエッチングがされ、材料の耐蝕性が劣るという欠点がある。

#### [発明が解決しようとする問題点]

従来、CVD装置に使用されているサセプタと 電極の材質は、アルミニウムか、ステンレスであ り、それらの材質はCVD装置内で、アルミニウ ムは化学的な耐蝕性は強いが、耐熱性が劣り、一 方ステンレスは、耐熱性が優れているが、反応が スによる化学的な耐蝕性が劣ることが問題点であ

る.

#### [問題点を解決するための手段]

第1図は本発明のプラズマCVD装置の要部断面図を示している。

CVDが行われる真空容器11内に配置された、 半導体ウエハのごとき基板14を載置するサセプタ 15と、電極17の表面部分を、チタンカーパイド膜 15′と17′で、厚みが少なくとも2μm以上で被 膜することにより達成できる。

#### 「作用]

本発明は、CVD装置における電極やサセプタの表面に、熱的に高温に耐え、且つ化学的な反応にも安定なチタンカーバイドの被膜を形成することにより、電極やサセプタを、物理的化学のにより、電極やサセプタを、であって、このチタンカーバイドの被膜方法として、プラズマ溶射法でであればでき、これによってを利用して被着することができ、これによってと数で表命のサセプタと電極ができ、高品位のC

VDを行うことができる。

#### [実施例]

本発明の一実施例である第1図のプラズマCV D装置について詳細に説明する。

CVDが行われる真空容器11があり、反応ガス 供給孔12と、反応ガス排出孔13がある。

真空容器の内部には、基板14を載置するサセプ ク15があり、このサセプタは加熱装置16によって 加熱される。

叉、基板14に対向して電極17が配置され、サセプタ15と電極17間には高周波電源18によって高周波電圧が印加されている。

本発明による C V D 装置では、サセプタ15と電極17の材料を、高耐熱性で耐蝕性にすることが目的であって、その方法として、アルミニウムやステンレス面が直接露出しないようにする必要があり、その最適の材料としてチタンカーバイドを用いて、サセプタ15と電極17の裏面に、チタンカーバイド暦15 と17 を形成したものである。

通常、このチタンカーバイド層の被膜方法として、第1にプラズマ溶射法を利用することができ、これは粒径が20μm ~30μm のチタンカーバイドを、粉体のままで、温度が1500で以上に成っているノズルの内部を通過させて、高温になった熱粉体を、シェットにして冷状態のステンレスであるサセプタの表面に投射することにより、チタンカーバイドを被着させるものである。

この場合の膜厚は100 μm 程度になり、十分な 被聴がなされる。

第 2 に、減圧 C V D 法により形成することもでき、この場合には 2 ~ 5 μm 程度の厚みが最適であるが、下記の反応によって形成される。

真空度

: 1 0 0 Torr

反応ガス

: 四塩化チタン (TiCl4)

メタンガス(CH4)

生成反応

: TiCl2 + CH4 --TiC

叉、fic をスパッタによって被着することもでき、fic をイオン衝撃することによってターゲットであるサセプタや電極の表面に被着するが、こ

の際の厚みは、2~5µm が最適である。

以上の方法のうち、CVD方法は密着性、緻密性の点で耐蝕性が最も優れているといえる。

以上は従来のアルミニウム又はステンレス等の 材料の表面に、チタンカーバイドを形成する場合 であるが、チタンカーバイド本体そのものを、電 極やサセプタに使用してもよい。

#### [発明の効果]

以上、詳細に説明をしたように、本発明のチタンカーバイドで被覆した電極やサセプタを用いることにより、長寿命で且つ高信頼性のCVD装置を提供することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明のプラズマCVD装置の要部 断面図、

第2図は、従来のプラズマCVD装置の要部断面図、

図において、

11は真空容器、

12は反応ガス供給孔、

13は反応ガス排出孔、14は基板、

15はサセプタ、

16は加熱装置、

17)+ 景体

18は髙周波電源、

15′と17′はチタンカーパイド層、

をそれぞれ示している。

代理人 弁理士 松岡宏四郎



